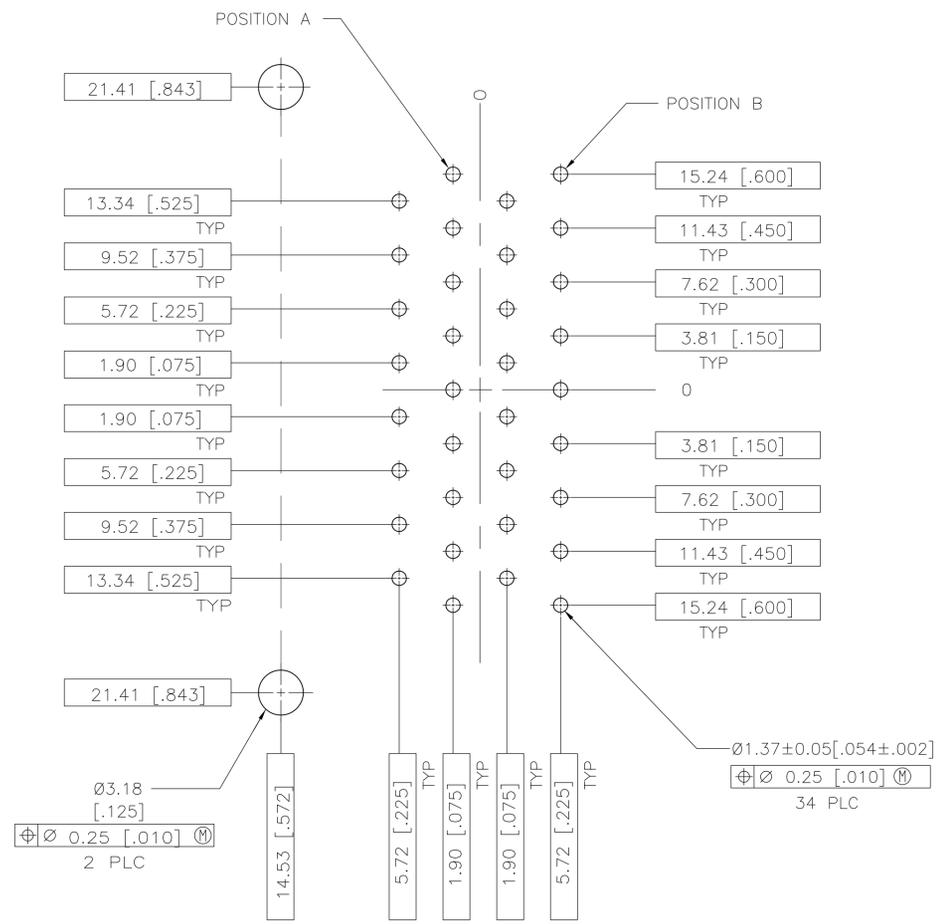
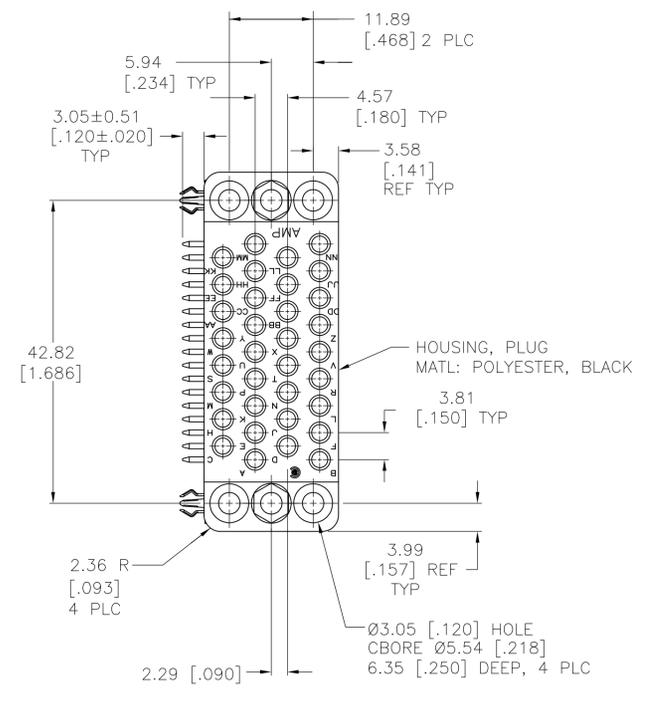
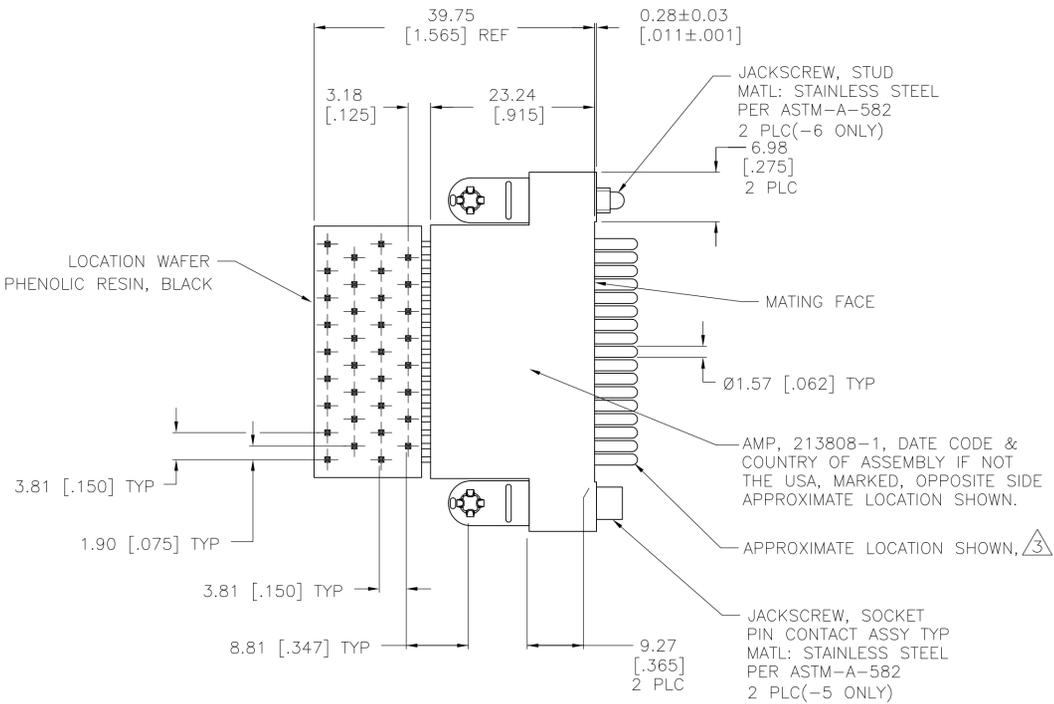
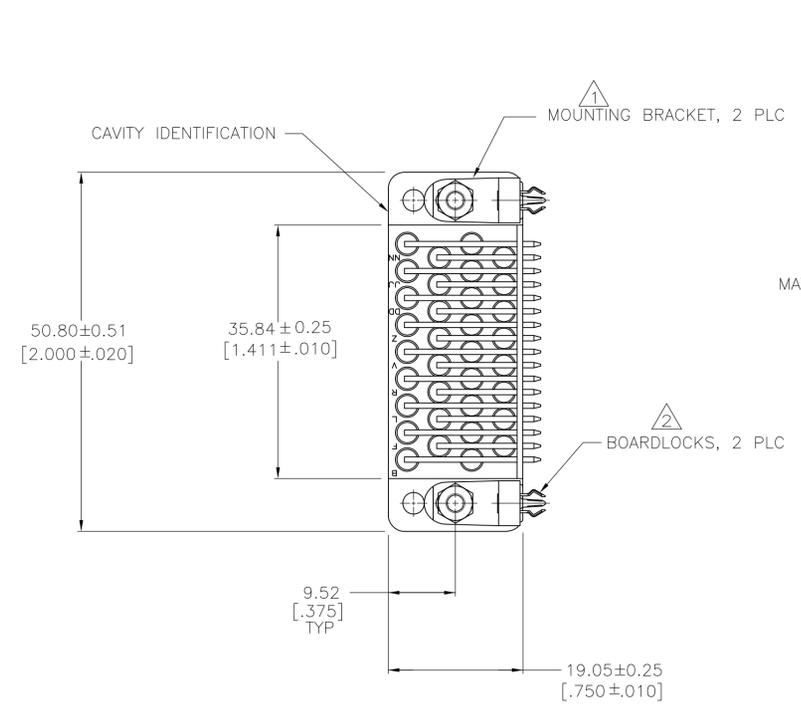
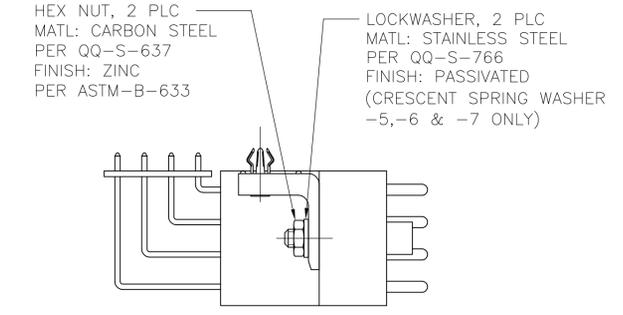


| REVISIONS | | | | | |
|-----------|-----------|---------------------------|----|------|------|
| REV | DATE | DESCRIPTION | BY | CHKD | APVD |
| E4 | 21SEP2016 | REVISED PER ECO-16-013463 | | NK | MZ |
| F | 28FEB2017 | REVISED PER ECR-17-002064 | | RS | MZ |



RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT SCALE 4:1



- MOUNTING BRACKET:** MATERIAL: ZINC PER QQ-Z-363. FINISH: 3.81um [0.000150] MIN NICKEL PER QQ-N-290 OVER 2.54um [0.000100] MIN COPPER PER MIL-C-14550.
- BOARDLOCK:** MATERIAL: COPPER ALLOY PER ASTM-B-592. FINISH: 5.08um [0.000200] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 1.27um [0.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- PIN CONTACT ASSEMBLY:** BODY MATERIAL: BRASS PER MIL-C-50. FINISH: 0.76um [0.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 FOR A LENGTH OF 5.08 [0.200] MIN FROM MATING END, 2.54um [0.000100] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 6.35 [0.250] MIN FROM OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27um [0.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290. SPRING-MATERIAL: STAINLESS STEEL PER QQ-S-766. POST-MATERIAL: BRASS PER ASTM-B-134. FINISH: 2.54um [0.000100] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 1.27um [0.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- PIN CONTACT ASSEMBLIES ARE SELECTIVELY LOADED INTO HOUSING AND LOCATION WAFER AT CIRCUITS A,B,C,D,E,F,H,K,P,R,S,T,U,V,W,X,Y AND AA. NO HARDWARE IS SUPPLIED.**
- PIN CONTACT ASSEMBLY:** BODY MATERIAL: BRASS PER MIL-C-50. FINISH: 0.76um [0.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 FOR A LENGTH OF 5.08 [0.200] MIN FROM MATING END, 2.54um [0.000100] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 6.35 [0.250] MIN FROM OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27um [0.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290. SPRING-MATERIAL: STAINLESS STEEL PER QQ-S-766. POST-MATERIAL: BRASS PER ASTM-B-134. FINISH: 2.54um [0.000100] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 1.27um [0.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- BOARDLOCK:** MATERIAL: COPPER ALLOY PER ASTM-B-592. FINISH: 5.08um [0.000200] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 1.27um [0.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- OBSOLETE PARTS:** OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

| REV | DESCRIPTION | DATE | BY | CHKD | APVD |
|-----|-------------|------|----|------|------|
| 7 | OBSOLETE | | | | |
| 6 | OBSOLETE | | | | |
| 5 | OBSOLETE | | | | |
| 4 | OBSOLETE | | | | |
| 3 | OBSOLETE | | | | |
| 2 | OBSOLETE | | | | |
| 1 | SUPERSEDED | | | | |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIN D.BROCKWAY 08-22-94. R.STONE 09-08-94.

TE Connectivity

CONNECTOR ASSEMBLY, PIN, 34 POSITION, RIGHT ANGLE, M SERIES

SIZE: A1, CASE CODE: 00779, DRAWING NO: 213808, WEIGHT: --, RESTRICTED TO: --

CUSTOMER DRAWING, SCALE: 2:1, SHEET: 1 OF 1, REV: F

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9